

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2024-029

## 江苏长电科技股份有限公司

### 2024 年度为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

1、被担保人名称：江阴长电先进封装有限公司、星科金朋半导体（江阴）有限公司、长电科技（宿迁）有限公司、长电科技（滁州）有限公司、长电微电子（江阴）有限公司、长电国际（香港）贸易投资有限公司、JCET STATS CHIP PAC KOREA LIMITED（JSCK）、STATS CHIP PAC PTE. LTD.（SCL）、STATS CHIP PAC KOREA, LIMITED（SCK）、长电科技管理有限公司等。

2、对外担保累计金额：截至 2023 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司融资及其他业务累计担保余额为人民币 62.82 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 24.10%，无其他对外担保。

3、反担保情况：无

4、对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足控股子公司 2024 年经营发展需要，公司拟为境内外控股子公司提供总额度不超过 150 亿元人民币的担保，其中为资产负债率 70% 以上的担保对象提供的担保额度不超过 60 亿元人民币。担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵质押担保、融资租赁担保、经营性租赁担保等；子公司被担保业务方式包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、应付帐款保函、海关税费保函、应收帐款保理、信用证业务等。具体额度如下：

- 对江阴长电先进封装有限公司担保不超过 2 亿元人民币；
- 对星科金朋半导体（江阴）有限公司担保不超过 15 亿元人民币；
- 对长电科技（宿迁）有限公司担保不超过 1 亿元人民币；

- 4、对长电科技（滁州）有限公司担保不超过 2 亿元人民币；
- 5、对长电微电子（江阴）有限公司担保不超过 15 亿元人民币；
- 6、对长电国际（香港）贸易投资有限公司担保不超过 13 亿元人民币；
- 7、对 JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（JSCK）担保不超过 11 亿元人民币；
- 8、对 STATS CHIPPAC PTE. LTD.（SCL）担保不超过 28 亿元人民币；
- 9、对 STATS CHIPPAC KOREA, LIMITED.（SCK）担保不超过 3 亿人民币；
- 10、对长电科技管理有限公司担保不超过 60 亿元人民币（资产负债率为 70%以上）。

上述额度为 2024 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率 70%以上的子公司不得从资产负债率 70%以下的子公司处获得担保额度。

## （二）履行的决策程序

2024 年度公司拟为控股子公司提供担保事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需股东大会批准。

在股东大会批准上述担保额度的前提下，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人士根据各子公司的申请，在上述时间及额度内视各子公司资金情况及业务需求予以安排具体担保事宜，包括但不限于确定担保方式、期限、金额、担保协议条款等，并签署相关法律文件；同时授权公司法定代表人在上述担保总额内，可根据实际经营情况在各子公司之间调配使用担保额度。

在 2024 年度股东大会召开日前，本公司为下属控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

## 二、担保对象简介

### 1、江阴长电先进封装有限公司

为本公司全资子公司，母公司持股 99.094%，全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司持股 0.906%的中外合资企业，注册资本 19,767 万美元，主营半导体芯片凸块及封装测试产品。

2023 年末，总资产为人民币 336,278.31 元，净资产为人民币 283,474.11 万元，2023 年营业收入为人民币 124,726.96 万元，净利润为人民币 9,076.62 万元。

## **2、星科金朋半导体（江阴）有限公司**

为本公司间接全资子公司，注册资本 32,500 万美元，主营集成电路研究、设计；BGA、PGA、CSP、MCM 等先进封装与测试，并提供相关的技术服务。

2023 年末，总资产为人民币 518,945.51 万元，净资产为人民币 322,201.78 万元，2023 年营业收入为人民币 348,496.08 万元，净利润为人民币 41,493.02 万元。

## **3、长电科技（宿迁）有限公司**

为本公司全资子公司，注册资本为人民币 109,000 万元，主营研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

2023 年末，总资产为人民币 195,462.87 万元，净资产为人民币 135,535.41 万元，2023 年营业收入为人民币 83,233.28 万元，净利润为人民币-3,298.12 万元。

## **4、长电科技（滁州）有限公司**

为本公司全资子公司，注册资本人民币 30,000 万元，主营研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

2023 年末，总资产为人民币 121,764.4 万元，净资产为人民币 87,546.76 万元，2023 年营业收入为人民币 83,209.16 万元，净利润为人民币 1,385.41 万元。

## **5、长电微电子（江阴）有限公司**

为本公司间接全资子公司，注册资本 50,000 万美元，主营电力电子元器件制造及销售；集成电路制造及销售；集成电路芯片及产品制造、销售；集成电路芯片设计及服务。

2023 年末，总资产为人民币 113,706.33 万元，净资产为人民币 75,666.60 万元，2023 年营业收入为人民币 803.19 万元。

## **6、长电国际（香港）贸易投资有限公司**

为本公司在香港设立的全资子公司，注册资本 24,800 万美元，主营进出口贸易。

2023 年末，总资产为人民币 266,118.13 万元；净资产为人民币 181,707.16 万元，2023 年营业收入为人民币 9,801.42 万元。

## **7、JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED (JSCK)**

为本公司全资子公司长电国际在韩国设立的全资子公司，主营高端封装测试产品，主要进行高阶 SiP 产品封装测试。

2023 年末，总资产 98,201.39 万美元，净资产 45,414.67 万美元，2023 年营业收入 173,187.39 万美元，净利润 3,543.44 万美元。

#### **8、STATS CHIPPAC PTE. LTD.(SCL)**

STATS CHIPPAC PTE. LTD.为本公司全资子公司，主营半导体封装设计、凸焊、针测、封装、测试和布线解决方案提供商。

2023 年末，总资产为 230,485.18 万美元，净资产为 136,417.51 万美元，2023 年营业收入 160,191.72 万美元，净利润 12,098.49 万美元。

#### **9、STATS CHIPPAC KOREA,LIMITED(SCK)**

STATS CHIPPAC KOREA, LIMITED 为本公司全资子公司，主营半导体封装设计、凸焊、针测、封装、测试和布线解决方案提供商。

2023 年末，总资产为 81,581.24 万美元；净资产为 59,795.37 万美元，2023 年营业收入为 79,274.07 万美元，净利润为 5,120.00 万美元。

#### **10、长电科技管理有限公司**

为本公司全资子公司，注册资本为人民币 100,000 万，主营投资管理，研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置等。

2023 年末，总资产为人民币 555,656.98 万元，净资产为人民币 90,923.80 万元。

### **三、担保协议的主要内容**

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除在 2022 年度股东大会决议有效期及审批额度内已签署的协议外，尚未签订具体担保协议；2024 年度公司将根据以上公司的申请，视资金需求予以安排。

### **四、担保的必要性和合理性**

本公司现有担保均为向下属控股子公司提供的担保，该等担保均是支持各下属公司的生产经营发展，有利于公司业务的正常开展，不会损害公司及股东利益；公司对该等公司的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。

### **五、董事会意见**

公司第八届董事会第五次会议审议本担保议案时，全票同意，无反对弃权票。

## 六、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，累计对外担保余额为人民币 62.82 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 24.10%，无其他对外担保。

本公司无逾期担保情形。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日